



2015年10月28日

各 位

会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦1-1-1
代表者名 代表執行役社長 室 町 正 志
(コード番号: 6502 東、名)
問合せ先 広報・IR室長 長谷川 直人
Tel 03-3457-2100

当社システムLSI事業及びディスクリート半導体事業の構造改革について

当社は、課題事業の抜本的な構造改革の一環として、このたび半導体事業におけるシステムLSI事業、ディスクリート半導体事業の構造改革についての方針を決定しましたので下記のとおりお知らせします。

システムLSI事業については、注力領域の明確化と固定費削減を目的として、同事業の一部であるCMOSイメージセンサ事業からの撤退を決定し、ソニー株式会社（以下、ソニー）との間で、大分工場の300mmウェハー製造ラインに係る資産を、ソニーに譲渡する旨の意向確認書を本日締結しました。あわせて、システムLSI事業における200mmおよび150mmウェハー製造ラインの効率的な一体運営を目的に、大分工場と岩手東芝エレクトロニクス株式会社を統合する新会社発足の準備を進めることを決定し、また、ディスクリート半導体事業については、白色LED事業を終息し、パワー半導体事業等への経営資源の集中を図ることとしました。

記

1. 概要と目的

(1) システムLSI事業におけるCMOSイメージセンサ事業の撤退について

システムLSI事業の注力領域の明確化と固定費削減を目的として、同事業の一部であるCMOSイメージセンサ事業からの撤退を決定し、あわせて、ソニーとの間で、大分工場の300mmウェハー製造ラインに係る資産を、ソニーに譲渡する旨の意向確認書を本日締結しました。

今後、ソニーによる譲渡対象資産の精査の手続き等を経て、確定契約の締結に向けて譲渡に関する詳細な取引条件の協議を進めてまいります。また、譲渡対象となっている施設及び設備での製造、並びにCMOSイメージセンサの設計などに関わっている当社及びその関係会社の従業員約1,100名については、ソニーへの譲渡完了に伴い、ソニーグループに移籍することで調整を行います。今後、関係当局の必要な承認及び認可を条件として、2015年度中の譲渡完了を目指します。なお、CMOSイメージセンサ事業は、当社システムLSI事業の一部であり、売上規模は約300億円（2014年度連結）です。

本件につきましては、本日付「ソニー及び東芝による半導体製造設備等の一部譲渡に関する意向確認書の締結について」においてもお知らせしておりますので、あわせてご参照ください。

(2) システムLSI事業における新会社の発足について

システムLSI事業において、車載用を含むアナログIC、モータ制御ドライバなど市場の成長が見込まれ、技術的優位性が高い注力分野へ経営資源を集中するほか、200mm及び150mmウェハー製造ラインの効率的な一体運営を目的に、大分工場を岩手東芝エレクトロニクス株式会社に統合する新会社発足の準備を進めます。また、新会社では、アナログ製品を中心としたファウンダリ需要を取り込むことにより、製造ラインの稼働率を改善し、コスト競争力の強化を図ります。今後、適切な統合スキームの検討を行い、登記等必要な手続きを経て2016年4月1日を目途に新会社を発足させる計画です。なお、新会社の概要につきましては、今後、決定次第お知らせします。

■東芝 大分工場について

所在地 : 大分県大分市大字松岡 3500 番地
設立 : 1970 年 7 月
工場長 : 森 重哉
従業員数 : 2,400 名 (2015 年 9 月末)
主な製品 : アナログ IC・ASIC等のシステムLSI、CMOSイメージセンサ

■岩手東芝エレクトロニクス株式会社について

会社名 : 岩手東芝エレクトロニクス株式会社
本社所在地 : 岩手県北上市北工業団地 6 番 6 号
設立 : 1973 年 1 月
代表者 : 取締役社長 安部 仁則
資本金 : 150 億円 (東芝 100%出資)
従業員数 : 800 名 (2015 年 9 月末)
主な製品 : アナログ IC・ASIC等のシステムLSI

(3) ディスクリート半導体事業における白色LED事業の終息について

ディスクリート半導体事業において、抜本的に事業体制を見直し、収益力改善および市場競争力強化を目的に、2015年度末までに白色LED事業を終息します。これにより、市場拡大が見込まれるパワー半導体事業、光デバイス事業、小信号デバイス事業を注力領域と位置付け、ディスクリート半導体事業全体の早期黒字化を目指します。終息に伴う発生費用は、下記の人員施策関連を除いて200億円程度の見込みです。

2. 上記構造改革に伴う人員再配置および再就職支援を含む早期退職優遇制度について

上記の構造改革に伴い、システムLSI事業、ディスクリート半導体事業及びセミコンダクター&ストレージ社の営業・スタッフ部門を対象に、セミコンダクター&ストレージ社内での再配置及び再就職支援を含む早期退職優遇制度を実施します。本施策に伴い発生する費用については現時点では未定です。今後、開示すべき事項を決定した場合には速やかに公表いたします。

3. 今後の見通し

本件の当社業績にあたる影響は詳細を精査中ですが軽微と見込まれます。2015年度(2016年3月期)の業績予想につきましてはまとも次第お知らせいたします。

なお、上記施策展開により、固定費について2014年度と比較して、2016年度にシステムL S I事業で約160億円、ディスクリート半導体事業で約100億円の削減を図り、2016年度中に両事業の黒字化を目指します。今後、このたびの構造改革の進捗に関して、お知らせすべき事項が生じた場合、速やかに発表いたします。

以 上

(参考)

前期連結実績(2015年3月期)

	売上高	営業利益	継続事業税引前 当期純利益	当社株主に帰属 する当期純利益
前期連結実績 (2015年3月期)	6,655,894百万円	170,439百万円	136,644百万円	△37,825百万円